

# 2025年度 第3四半期 決算説明資料

2026.1.21

## 将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位：百万円)	FY2025 3Q
売上高	109,291
売上総利益	78,064
GP率	71.4%
販売管理費	30,723
営業利益	47,340
経常利益	46,985
経常利益率	43.0%
税前利益	46,801
純利益	36,726

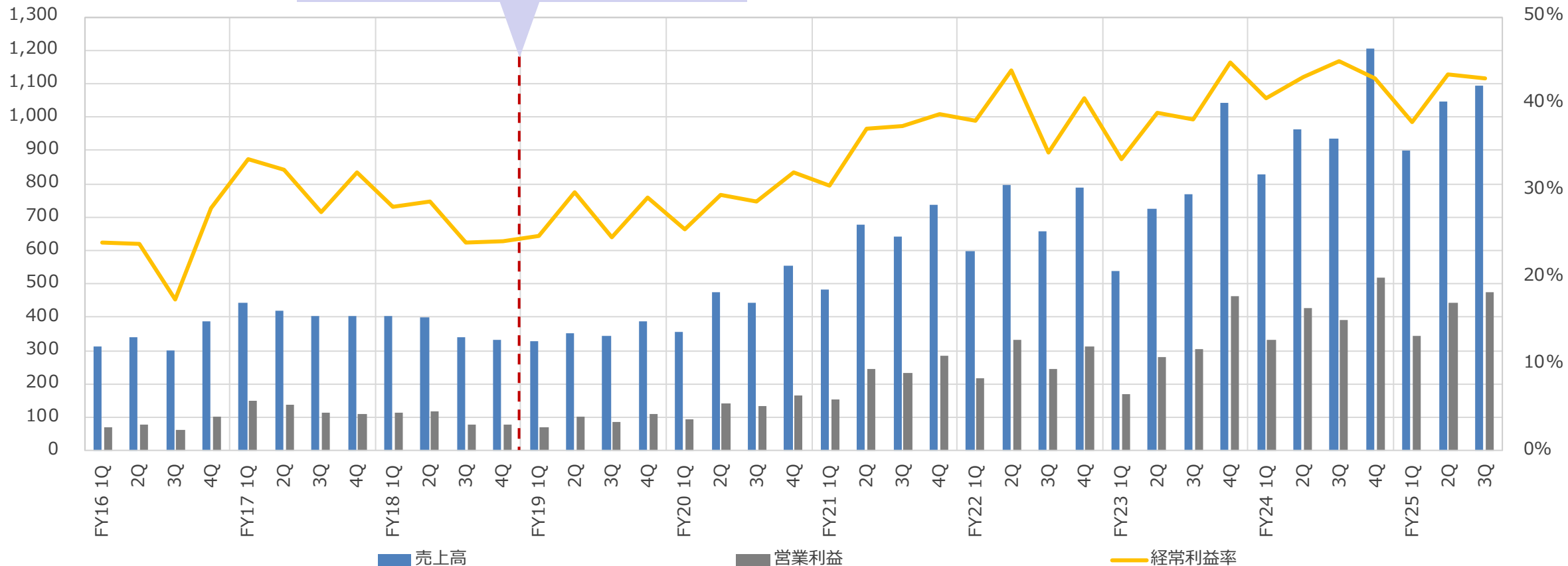
FY2025 2Q	QoQ	
	差額	(%)
104,622	4,669	4.5%
72,748	5,316	7.3%
69.5%	1.9p	-
28,357	2,367	8.3%
44,391	2,949	6.6%
45,466	1,520	3.3%
43.5%	-0.5p	-
44,918	1,883	4.2%
32,145	4,581	14.3%

FY2024 3Q	YoY	
	差額	(%)
93,553	15,738	16.8%
66,622	11,442	17.2%
71.2%	0.2p	-
27,476	3,247	11.8%
39,145	8,195	20.9%
42,027	4,959	11.8%
44.9%	-1.9p	-
41,866	4,935	11.8%
31,809	4,917	15.5%

売上高： QoQ 機械装置の検収進捗および消耗品出荷堅調により増収  
 GP率： QoQ 高付加価値製品の貢献および為替影響により収益性上昇  
 販売管理費： QoQ 人件費や研究開発費が増加

(単位：億円)

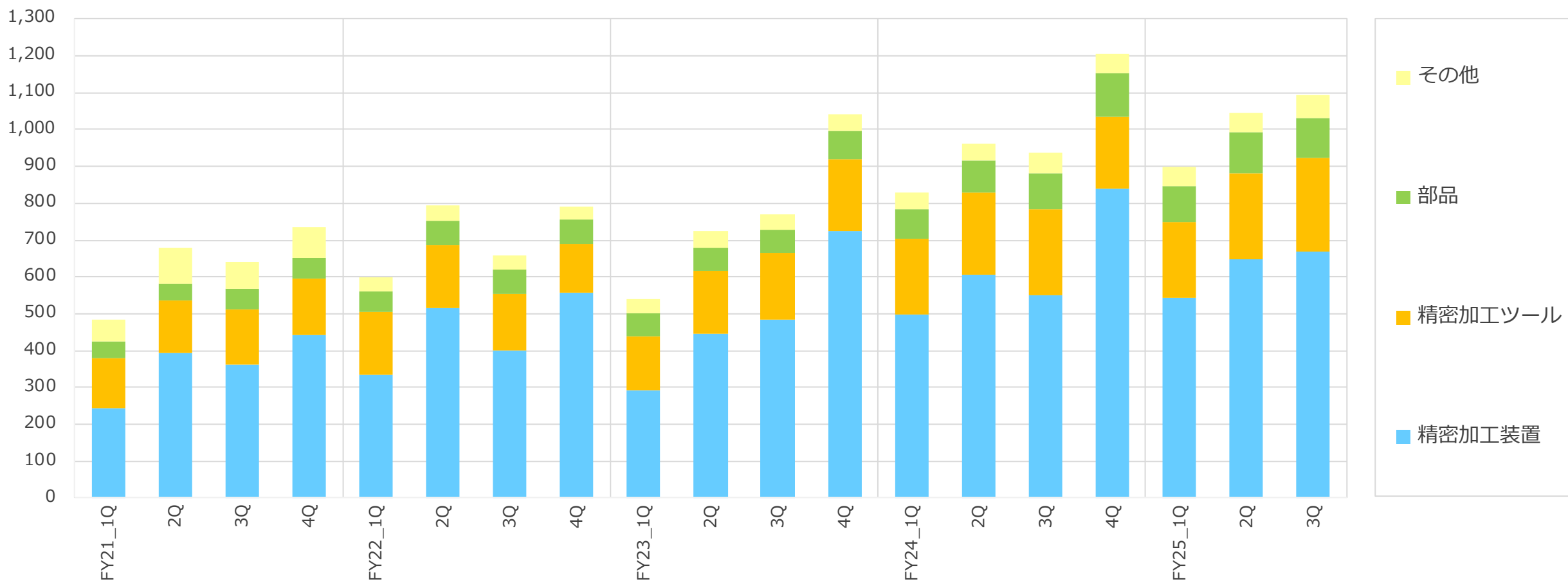
会計方針変更により  
収益認識のタイミングを検収時に変更



FY25\_3Q 営業利益率43.3% 経常利益率43.0% 純利益率33.6%  
※数値推移は、Webサイト「補足情報」に記載

# 製品群別売上高 四半期推移

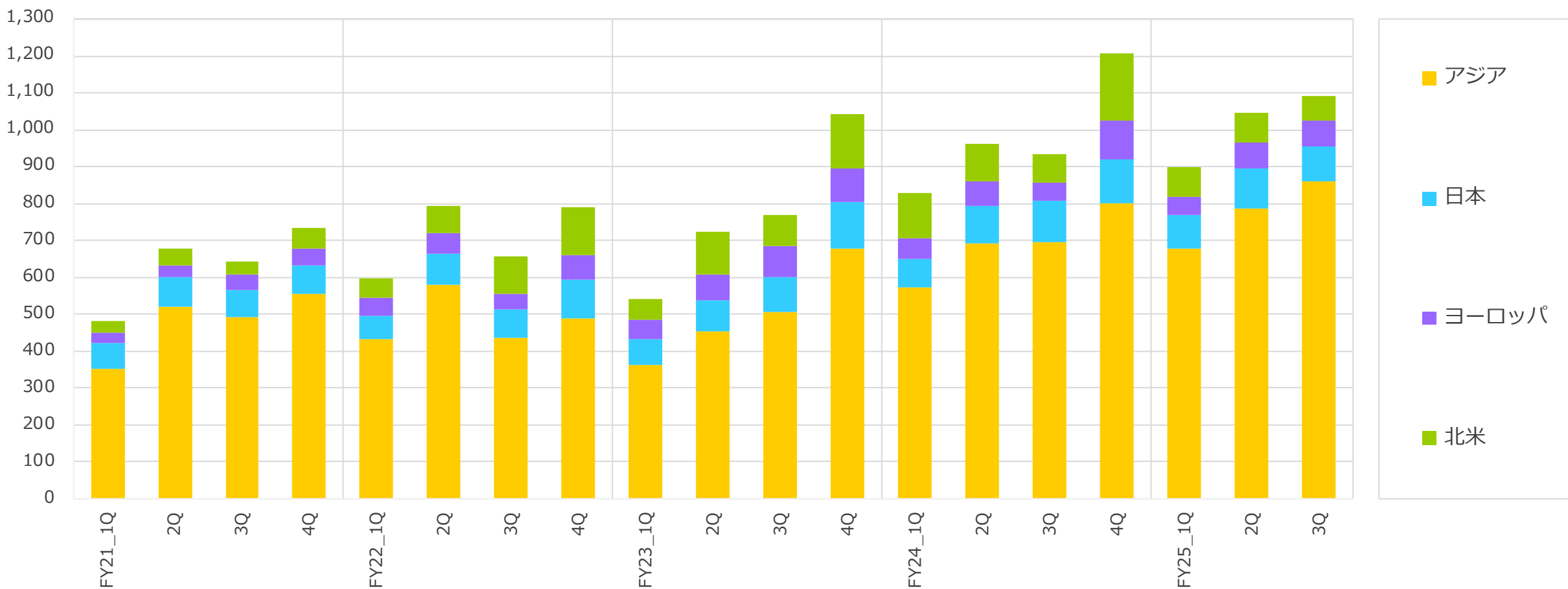
(単位：億円)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

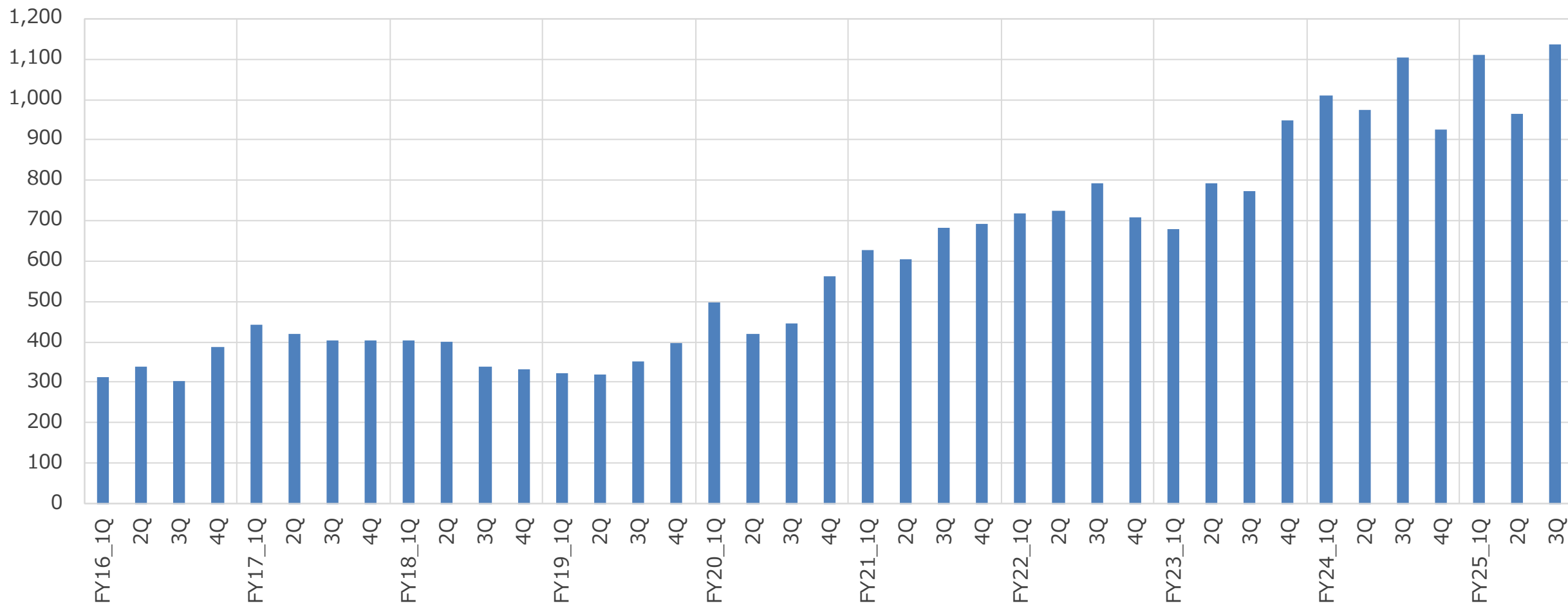
# 地域別売上高 四半期推移

(単位：億円)



FY25\_3Q 海外売上高比率 91.5%

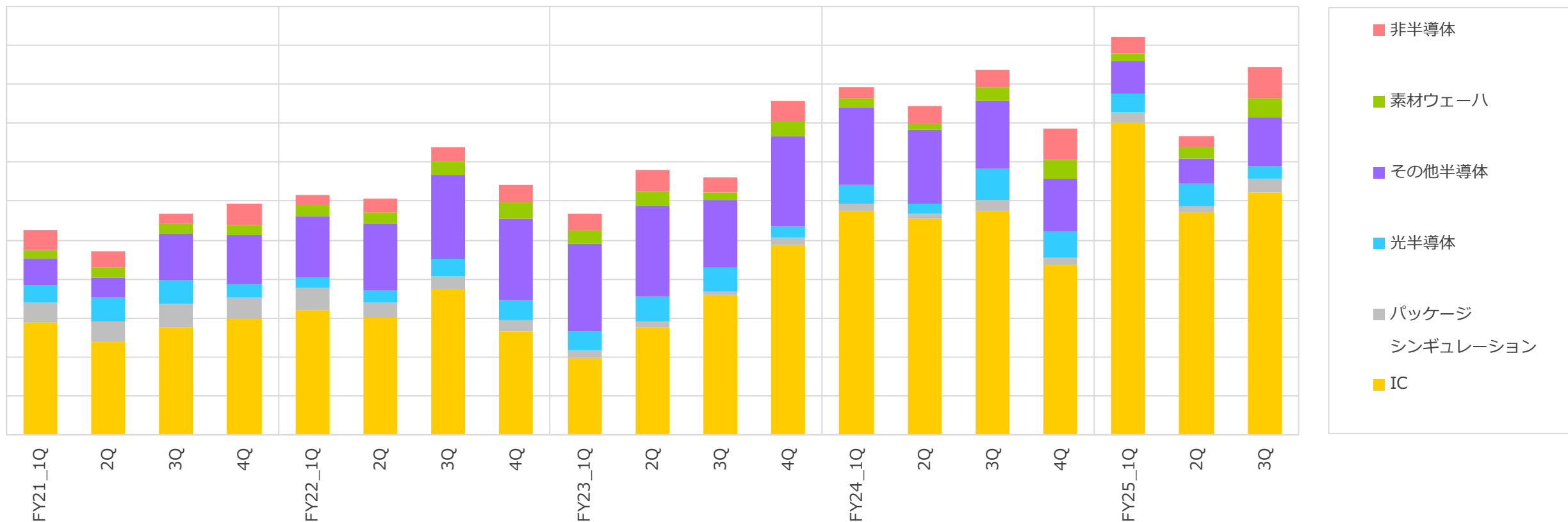
(単位：億円)



FY25\_3Q 出荷額 1,136億円 (過去最高)

出荷額ベース

精密加工装置

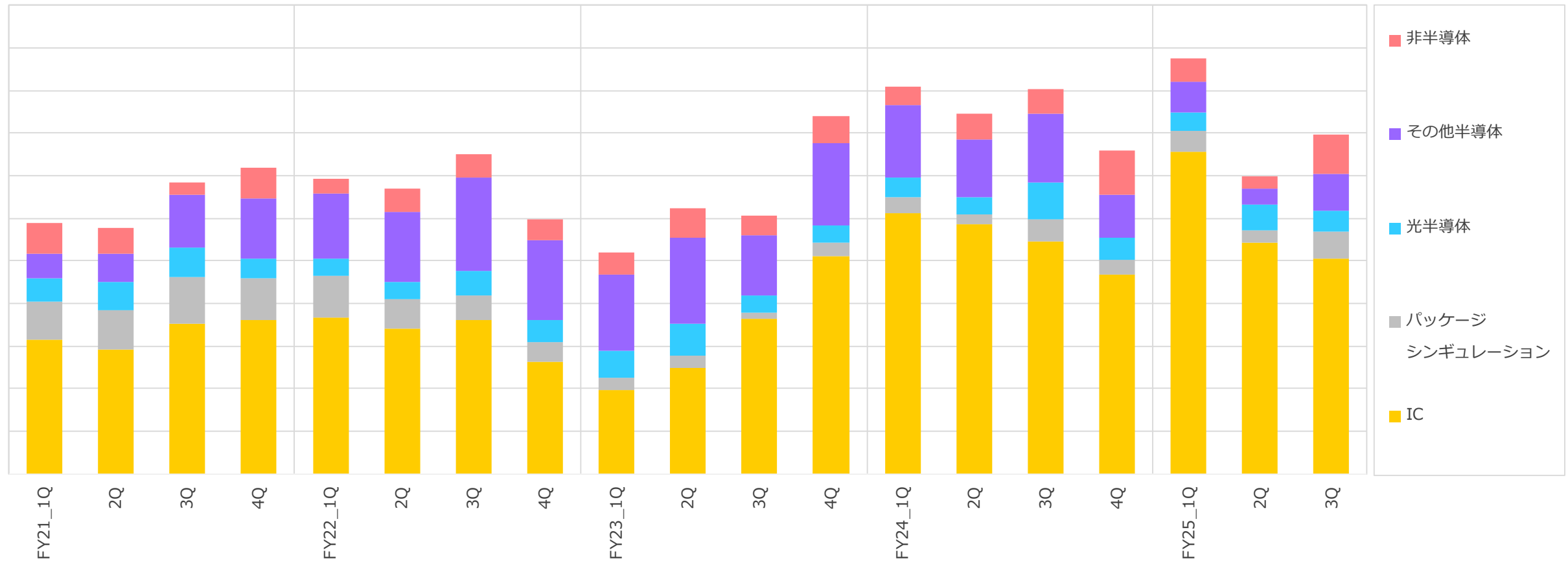


QoQ  
YoY

堅調な生成AI向けに加え、非IC用途の増加が全体を押し上げた  
堅調な生成AI向けが全体をけん引する形は変わらず

出荷額ベース

ダイサ



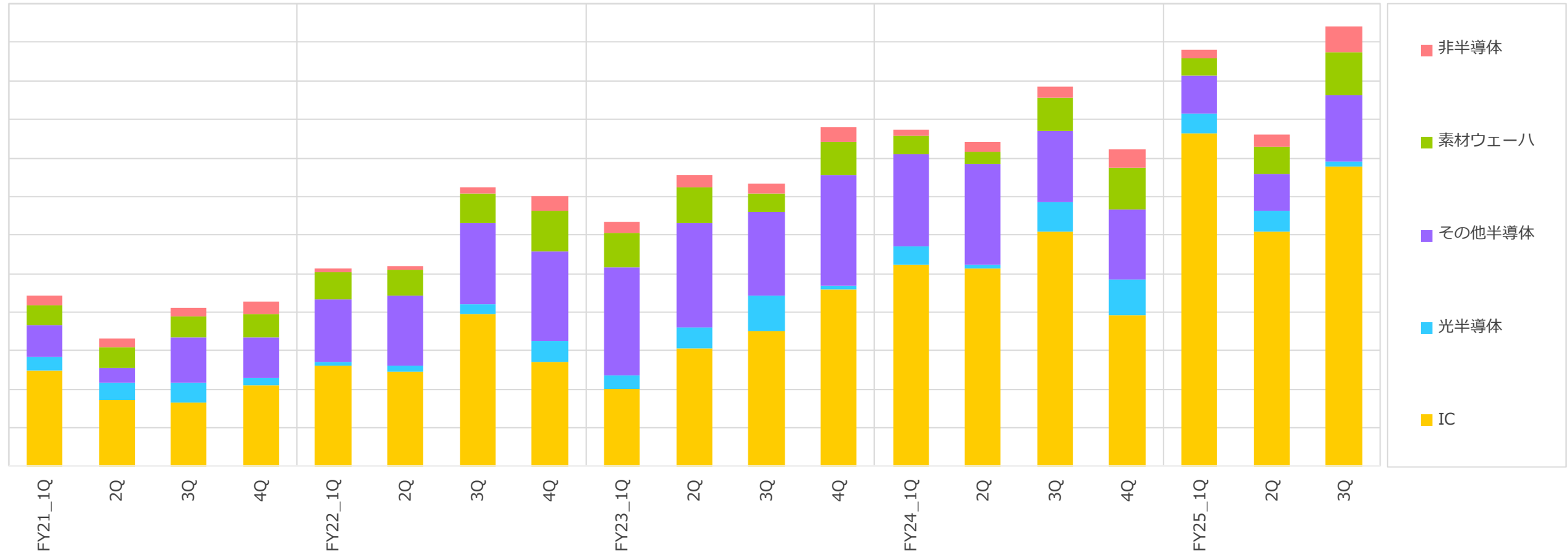
QoQ  
YoY

その他半導体（主にパワー半導体）と非半導体が増加  
その他半導体（主にパワー半導体）向けが減少

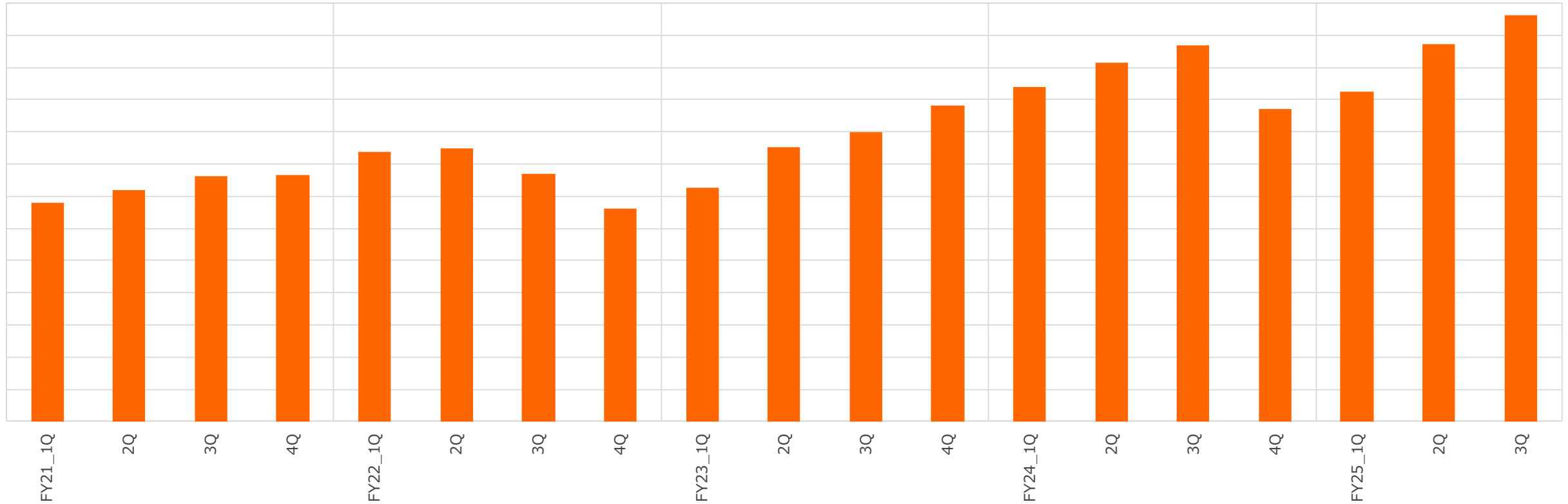


出荷額ベース

グラインダ



QoQ ICおよび、その他半導体（主にパワー半導体）向けが増加  
YoY 生成AI向けを中心にIC向けが増加



顧客の設備稼働率等を背景に前四半期から増加し過去最高を更新

(単位：百万円)	FY2025 3Q	FY2025 2Q	差額
現金及び預金	246,143	222,909	23,234
受取手形・売掛金	50,761	53,785	-3,025
棚卸資産	141,596	138,741	2,855
流動資産	446,956	421,647	25,308
有形固定資産	211,567	210,997	571
固定資産	231,307	229,746	1,561
総資産	678,263	651,394	26,870
流動負債	134,719	132,726	1,992
固定負債	932	960	-28
負債合計	135,652	133,687	1,965
純資産	542,611	517,706	24,905
負債純資産合計	678,263	651,394	26,870
自己資本比率	79.8%	79.2%	0.6p

総資産：主に現預金や棚卸資産が増加

負債：未払法人税等が減少した一方、契約負債や仕入債務などが増加

純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：億円)

今回予想

	FY24 1Q	2Q	3Q	4Q	FY25 1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	828	962	936	1,207	899	1,046	1,093	1,152
営業利益	334	426	391	517	345	444	473	459
経常利益	336	414	420	519	340	455	470	459
純利益	237	297	318	386	238	321	367	338
営業利益率	40.3%	44.3%	41.8%	42.8%	38.4%	42.4%	43.3%	39.8%
経常利益率	40.6%	43.0%	44.9%	43.0%	37.8%	43.5%	43.0%	39.8%
純利益率	28.6%	30.9%	34.0%	32.0%	26.5%	30.7%	33.6%	29.3%
出荷額	1,011	976	1,103	925	1,111	963	1,136	1,169

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 4Q (1-3月期)  
為替感応度 (年換算)

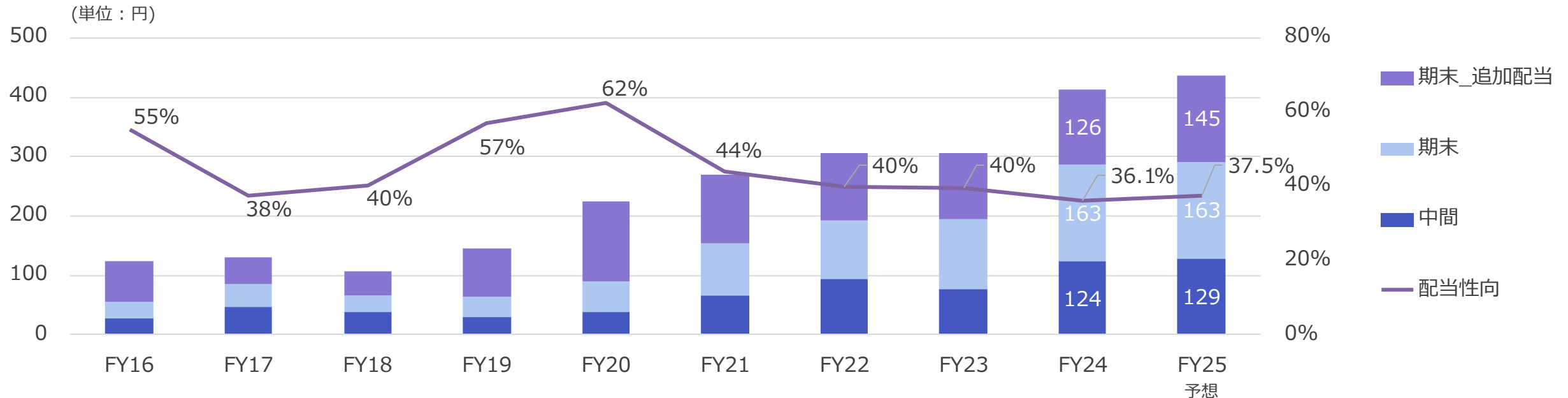
US\$ : 154円  
US\$ : 約17億円

Euro : 181円  
Euro : 約1億円

## 【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(\*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

\*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY25 中間（実績）129円 期末（予想）308円

※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施  
（FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載）

## 今回予想

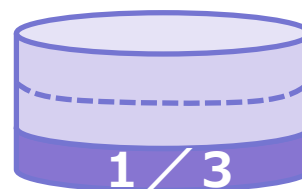
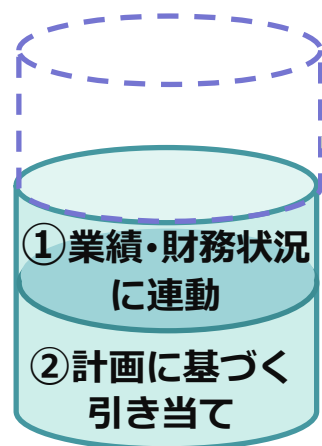
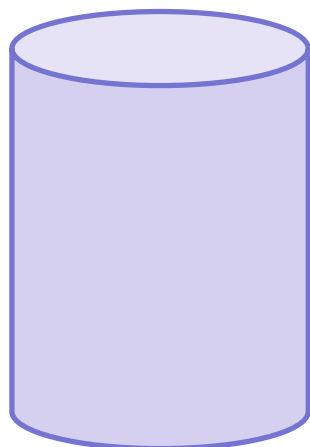
年度末現預金  
1,954億円 ※

—

必要資金  
1,484億円

=

余剰資金  
470億円



156億円

追加配当

## 必要資金の内訳

①	<b>運転資金</b>	<b>698</b> 億円
	前期 連結売上高 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月	
	<b>技術購入予備費(M&amp;A含む)</b>	<b>320</b> 億円
	連結売上高 過去3年平均 × 10%	
	<b>長期有利子負債 返済資金</b>	—
	<b>税金・配当 等</b>	<b>302</b> 億円
②	<b>設備拡張資金</b>	<b>164</b> 億円
	広島新工場 等	

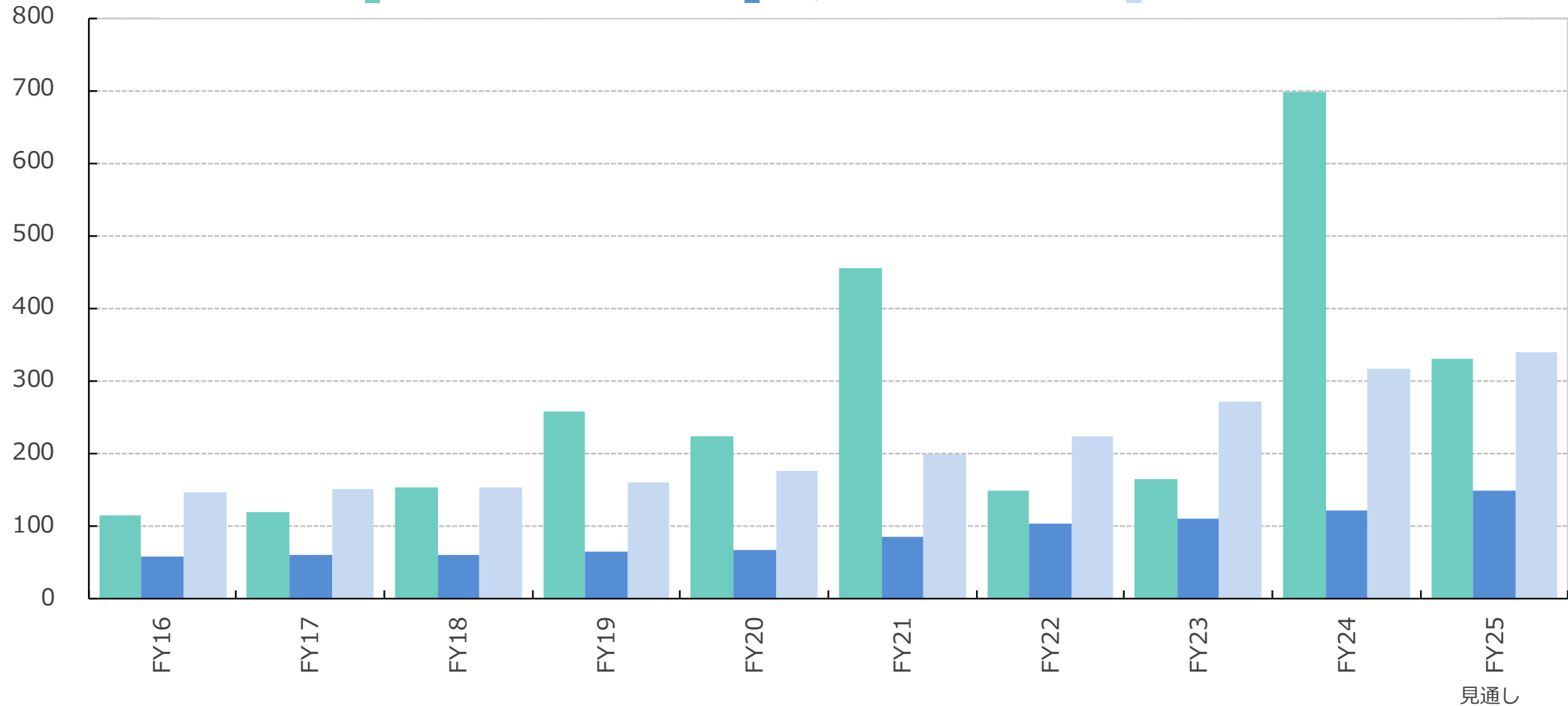
※ 契約負債（前受金）金額などを考慮

(単位：億円)

■ 設備投資

■ 減価償却

■ 研究開発



FY25見通し

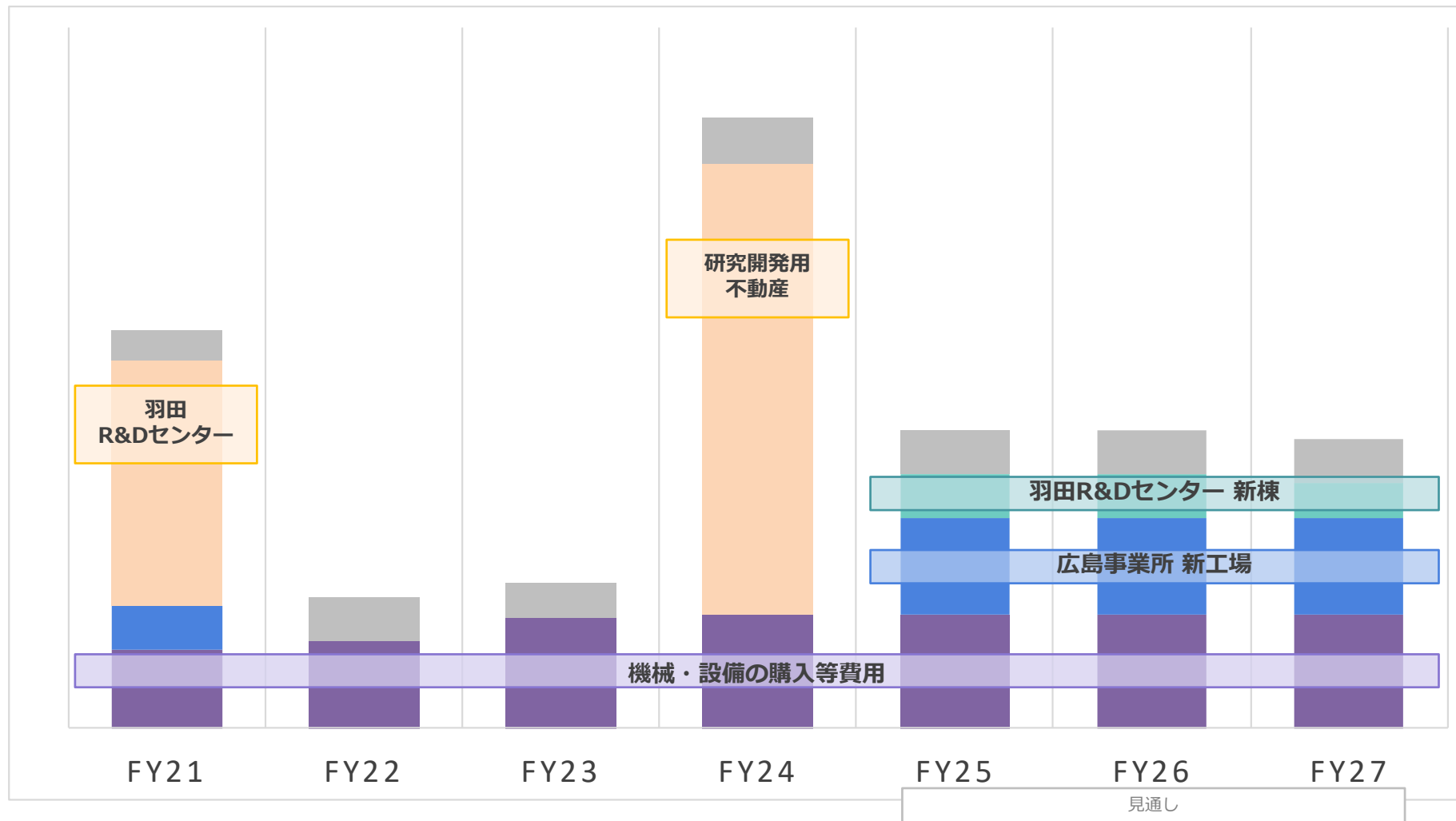
設備投資：約330億円

減価償却：約150億円

研究開発：約340億円

合理化投資、羽田R&Dセンター建替、新工場建築を含む

積極的な研究開発活動を継続



研究開発用不動産  
羽田R&Dセンター 新棟  
広島事業所 新工場

約500億円  
約140億円  
約330億円

支出時期：FY24  
支出時期：FY25～FY27  
支出時期：FY25～FY27



出荷額ベース

製品群		見通し FY25_4Q 増減率 (QoQ)
	ブレードダイサ	30%
	レーザーソー	20%
	ダイサ	25%
	グラインダ	-10%
	周辺装置	80%
精密加工装置		10%
精密加工ツール		-5%
その他		-15%

## 【ご参考】製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	3Q		
	構成比	QoQ	YoY
精密加工装置合計	61%	23%	0%
内、ダイサ	28%	14%	-12%
ブレードダイサ	13%	-6%	-25%
レーザーソー	15%	41%	4%
内、グラインダ	30%	32%	16%
内、周辺装置	3%	30%	-14%
精密加工ツール	22%	8%	9%
その他	17%	14%	9%
出荷額合計	100%	18%	3%

出荷額ベース

		FY24				FY25		
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q	25-3Q
ダイサ	1_IC	67%	69%	60%	62%	78%	78%	64%
	2_パッケージ・シグネーチャ	4%	3%	6%	4%	5%	4%	8%
	3_光半導体	5%	5%	10%	7%	5%	9%	6%
	4_その他_半導体	19%	16%	18%	13%	7%	5%	11%
	5_非半導体	5%	7%	7%	14%	6%	4%	11%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	60%	61%	62%	48%	80%	71%	68%
	2_光半導体	6%	1%	8%	11%	5%	6%	1%
	3_その他_半導体	27%	31%	19%	22%	9%	11%	15%
	4_素材ウエーハ	6%	4%	9%	14%	4%	8%	10%
	5_非半導体	2%	3%	3%	6%	2%	4%	6%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

		FY24				FY25		
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q	25-3Q
ダイサ	1_IC	210%	135%	50%	-8%	23%	-7%	-7%
	2_パッケージ・シングュレーション	23%	-15%	270%	7%	33%	14%	24%
	3_光半導体	-26%	-46%	112%	26%	-5%	50%	-47%
	4_その他_半導体	-3%	-33%	15%	-48%	-58%	-72%	-45%
	5_非半導体	-17%	-13%	26%	65%	34%	-54%	55%
ダイサ		75%	36%	49%	-10%	7%	-17%	-12%
グラインダ	1_IC	160%	68%	73%	-14%	66%	18%	28%
	2_光半導体	46%	-86%	-15%	819%	-1%	652%	-84%
	3_その他_半導体	-16%	-4%	-15%	-37%	-59%	-63%	-5%
	4_素材ウエーハ	-45%	-62%	79%	26%	-8%	104%	28%
	5_非半導体	-50%	-24%	19%	31%	46%	29%	125%
グラインダ		37%	11%	34%	-6%	24%	2%	16%

## 出荷額ベース

		FY24				FY25		
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q	25-2Q	25-3Q
ダイサ	1_IC	20%	-4%	-7%	-14%	62%	-28%	-7%
	2_パッケージ・シグネーチャ	14%	-34%	119%	-35%	43%	-44%	138%
	3_光半導体	10%	-12%	115%	-40%	-16%	40%	-23%
	4_その他_半導体	-11%	-22%	19%	-37%	-28%	-48%	134%
	5_非半導体	-34%	46%	-3%	77%	-47%	-50%	227%
ダイサ		8%	-7%	7%	-16%	29%	-29%	14%
グラインダ	1_IC	14%	-2%	18%	-35%	120%	-30%	28%
	2_光半導体	402%	-85%	952%	20%	-46%	10%	-78%
	3_その他_半導体	-17%	10%	-29%	-3%	-46%	-1%	80%
	4_素材ウエーハ	-45%	-29%	148%	29%	-59%	56%	56%
	5_非半導体	-59%	62%	24%	61%	-55%	44%	115%
グラインダ		-1%	-4%	17%	-16%	31%	-20%	32%

検収ベース

■ 構成比	FY2024				FY2025		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
日本	9%	11%	12%	10%	10%	10%	9%
アメリカ	15%	10%	8%	15%	9%	8%	6%
アジア	69%	72%	74%	66%	75%	75%	79%
シンガポール	6%	8%	8%	7%	7%	7%	10%
台湾	16%	17%	19%	22%	27%	28%	28%
韓国	14%	12%	9%	9%	9%	10%	6%
中国 ※	32%	33%	37%	27%	30%	28%	34%
その他	1%	1%	1%	2%	3%	2%	1%
ヨーロッパ	7%	7%	5%	9%	6%	7%	6%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

**当社ではMissionの実現性の向上に取り組むことで、  
結果として企業価値の向上と競争力向上に繋がり、  
資本市場の皆さまの期待に応えることができると考えています**

- ✓ 事業の質の追求
- ✓ 自己資金の活用と目的
- ✓ 株主還元方針
- ✓ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

上記の考え方について[詳しくはこちら](#)をご確認ください



### 本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

### 表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY（Fiscal Year）と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。

金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。

%は実際の金額を基に算出しています。

### 将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

英語圏の方々のために英語資料を提供する場合、和文（原文）と英訳の内容が相違した際は和文の内容が優先されます。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>